

基本資料表

公司名稱	頤邦科技股份有限公司		
負責人	吳非艱	統一編號	16130009
聯絡人	余珮吟	職稱	正管理師
聯絡電話	(03)567-8788 #22303	傳真	(03)567-8690
公司地址	□□□ (總部)新竹市力行五路三號 (工作地點) 新竹縣湖口鄉光復路 12 號		

E-mail	mandyy@chipbond.com.tw				
公司簡介	頤邦科技成立於 1997 年 7 月，為利基型的半導體封裝與測試服務供應商，主要業務為提供顯示器驅動 IC 後段封裝及測試代工服務，其中驅動 IC 封裝包括前段之金凸塊製程與後段之 TCP 及 COG 封裝，及覆晶封裝並包括前段之錫鉛凸塊製作。 頤邦科技原在金凸塊的產能位居全球第一大，於 2010 年 4 月與飛信進行合併，合併後，包括 Wafer test、COF、COG 的產能由第二名躍升為全球第一大，成為全球第一大驅動 IC 封裝公司！ 我們提供產學專班學生最直接的生產技術訓練，並規劃職涯發展的各項訓練與途徑，讓你在求學階段發覺自己所長，進而結合興趣與專業，持續學習與成長！本公司提供專班學生各項福利如下。歡迎你主動爭取學習機會！				
營業項目	◎營業項目 (1) 金屬凸塊(Wafer Bumping Service) (2) 金凸塊(Gold Bump) (3) 錫鉛凸塊(Solder Bump) (4) 捲帶式軟板封裝(TCP) (5) 捲帶式薄膜覆晶(COF，Chip on Film) (6) 覆晶(Flip Chip) (7) 玻璃覆晶封裝(COG，Chip on Glass) ◎產品營收比重分別為： 8 吋金凸塊約佔 29%、12 吋金凸塊約 12%、晶圓測試約佔 1 成，COF(捲帶式覆晶薄膜封裝)約佔 22%、COG(玻璃覆晶封裝)約佔 10%、Tape(COF 載板)約佔 16%。COF 因可重封，其主要應用於大尺寸面板，COG 則多用在小尺寸面板。 ◎以應用分： TV 佔約 45%、手機佔約 25%、平板電腦佔約 10、PC 及 NB 佔約 25%。				
資 本 額	65 億元	年營業額	168 億元	員工人數	5000 人(台灣)
轉帳銀行	第一銀行、台灣中小企業銀行、兆豐商銀、台新銀行、中國信託或台北富邦銀行，上列其中一家即可	事先開戶	☒ 是 ☐ 否	膳宿狀況	☒ 公司提供膳食(午/晚/消夜)、住宿/交通
是否輪班	☒ 是 ☐ 否	上班時間	日夜輪班(半年) 日班 07:20~19:20 夜班 19:20~07:20	休假方式	作四休二 (休假日需上課)
加班情況	☐ 不必加班 ☒ 偶而 ☐ 常態性加班		預估每月平均須加班時數	依產能需求調整，非固定	
提供保險	☒ 勞保 ☒ 健保 ☒ 團體保險 ☐ 意外險 ☐ 其他				

工作內容	名額	需求條件或專長	是否面談
生產技術人員 -機台操作 -利用工具顯微鏡找出產品異常	40	理工科系學生 對半導體封測產業有興趣者	☒ 是 ☐ 否
工作內容及特性	(1) 工作無危險性、若生產線有加班需求則需要配合。 (2) 須穿著全套無塵衣，因工作特性需久坐或久站。 (3) 日班 07:20~19:20；夜班 19:20~07:20，每學期日夜輪班，做四休二或作三休三。		
薪資	(做四休二)日班：\$29,600 元；夜班：\$37,300 元		
福利制度	(1) 報到第一天即加保勞保、健保、團保，提供完整的工作保障。 (2) 提供第一學期的註冊費定額補助 28,000 元；第二年分階段提供獎學金 10,000 元。 (3) 提供公司內部用餐補助、特約商店員工優惠折扣等福利。 (4) 獎勵學生勇敢踏入職場學習，提供助學金、獎學金，並期勉同學能夠儘早取得就業入場券。		